

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-121

武汉精测电子集团股份有限公司

关于完成以自有资金置换募集资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）分别于2023年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，2023年9月18日召开公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计14,798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”（以下简称“新项目”），新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”），项目总投资约为1.82亿元。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途暨变更承诺的公告》（公告编号：2023-120）。

截至本公告披露日，上海精测已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16,582.88万元（含利息1,784.14万元），上述资金已全部存储于募集资金专户内（账户号：121930086310918）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZE10571号《验证报告》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年8月15日